フリップチップ実装の信頼性―接続部の熱応力に関して―

塚田　裕 *

Reliability of Flip Chip Package—Thermal Stress on Flip Chip Joint—

Yutaka TSUKADA*

* 立命館大学大学院理工学研究科（〒 525-8577　滋賀県草津市野路東 1 丁目 1-1）
*Ritsumeikan University, Graduate School of Science and Engineering (1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577)